

**国投证券股份有限公司**  
**关于北京金橙子科技股份有限公司**  
**2025 年半年度持续督导跟踪报告**

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就金橙子 2025 年半年度（以下简称“本持续督导期”）持续督导跟踪情况报告如下：

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与金橙子签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期问访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解金橙子业务情况，对金橙子开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后予以披露。	金橙子在本持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	金橙子在本持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履	在本持续督导期间，保荐机构督导金橙子及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所

	行其所作出的各项承诺。	所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促金橙子依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促金橙子依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对金橙子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，金橙子及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，金橙子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，金橙子未发生左述情况。

14	发现以下情形之一的,督促上市公司作出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间,金橙子未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划,并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场检查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用;(三)可能存在重大违规担保;(四)控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(五)资金往来或者现金流存在重大异常;(六)上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间,金橙子未发生左述情况。

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

本持续督导期间,保荐机构和保荐代表人未发现金橙子存在需要进行整改的重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间,公司未发生重大风险事项。公司目前面临的主要风险因素如下:

### (一) 核心竞争力风险

#### 1、核心技术泄密及核心技术人员流失风险

随着市场及公司发展,存在因核心技术人员流失或者工作失误等偶发因素导致核心技术泄露的风险,会对公司竞争优势及生产经营产生不利影响。

若公司未来不能建立完备的激励机制、人才培养机制，无法有效吸引和保留关键核心技术人员和研发团队，将面临关键核心技术人员流失或高端人才不足，进而在技术研发突破和创新方面落后于竞争对手的风险，将对公司长期经营发展造成不利影响。

## **2、研发创新能力无法持续满足激光先进制造领域发展的风险**

若公司研发团队的研发创新能力无法有效满足公司相关技术及产品的研发需求，或无法满足下游激光先进制造的发展需求，均可能对公司的市场竞争能力及经营业绩造成不利影响。

公司将持续增强市场信息搜集能力，提升研发人员素质，不断吸纳高端人才，以提升公司的研发创新能力。

## **3、与国际厂商在高端应用领域存在差距的风险**

相比德国 Scaps、德国 Scanlab 等国际厂商，公司在中高端振镜产品一些性能指标、机器人和 3D 振镜联动加工技术、实时光束波动偏移补偿技术、激光熔覆等细节及技术方面尚存在一定差距；目前公司在高端应用领域的控制系统、振镜产品销售数量占比仍处于较低水平。故公司可能面临在高端应用技术方面无法赶超国外竞争对手，或在高端应用领域无法实现有效市场开拓的风险。

# **（二）经营风险**

## **1、新产品市场开拓风险**

公司根据市场需求持续进行控制系统的研发及更新，同时推出高精密振镜、3D 打印控制系统、焊接控制系统、消费级控制卡等产品。受到整体经济环境、市场需求变化、产品性能等多重因素影响，部分产品的客户验证、推广进度较为缓慢。公司新产品的开拓和发展需要一定的市场验证周期及客户积累，若在产品开发及客户开拓等方面不能取得预期进展，则面临新产品无法有效开拓市场的风险。

## **2、产品持续受盗版侵权的风险**

公司激光加工控制系统核心是工业软件，近些年行业内存在较严重的盗版行

为。打击盗版成本较高、难度较大，近几年盗版市场未受到有力约束。若未来无法通过增强加密方式及法律手段遏制盗版行为，公司将面临激光振镜控制产品持续被盗版、合法权益持续被侵害的风险，甚至长期经营发展受到不利影响。

公司将持续对产品加密方式进行增强及升级，以避免新产品被破解和盗版的可能；同时采取相应的法律手段，遏制和打击盗版产品的发展势头。

### **3、经营业绩波动的风险**

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、管理层经营决策等多方面因素影响。随着公司经营规模扩大，对公司在运营管理、内部控制、财务管理等方面提出更高的要求。

如果公司的内部管理流程和人员结构的调整未能及时满足规模扩大的要求，可能存在因规模扩张导致的管理和内控风险，对公司未来的持续盈利能力造成不利影响。公司将及时调整、建立适合业务发展的内部管理流程和内控体系，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

## **（三）财务风险**

### **1、存货跌价风险**

随着业务规模的不断扩大，公司各期存货金额略有上升。激光控制产品技术更新迭代速度较快，若未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备金额，从而对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

### **2、税务优惠风险**

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司销售自主开发的激光控制软件产品享受上述增值税即征即退优惠政策。若相关政策发生变化或者公司不能持续符合相应税收优惠条件，将对公司利润水平造成不利影响。

### **3、商誉减值风险**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司商誉的账面价值为 9,214,929.84 元，为公司收购武汉奇造 100%的股权之成本超过其可辨认净资产公允价值份额的金额。未来，若因经济环境波动、市场需求变化、武汉奇造经营管理出现重大失误等因素，导致其经营业绩不达预期，则上述收购形成的商誉存在相应的减值风险，从而可能对公司的经营业绩产生不良影响。

#### **（四）行业风险**

公司产品为激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备，均应用于工业激光加工应用领域，与激光加工行业的整体发展密切相关。公司存在因国家政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致激光加工制造领域市场发展不达预期，而使公司业务增长速度放缓，甚至业绩下降的风险。

#### **（五）宏观环境风险**

全球范围内各种冲突、博弈不断。部分地区局势陷入紧张，贸易冲突时有发生，全球地缘政治格局正在不断发生变化，也加剧了全球市场的不稳定。这些不确定性风险可能会对公司的海外市场带来一定影响。

公司产品的部分核心芯片目前主要来源于进口，若受到国际环境影响，芯片供给无法满足公司生产所需或成本上升，可能会对公司经营及业绩造成不利影响。公司已采用核心芯片海外多品牌采购路线，并同时预研了国产替代芯片并行的方案，以避免上述风险。

#### **（六）其他重大风险**

##### **1、募投项目实施风险**

公司募投项目的可行性研究系基于当时产业政策、市场环境等因素作出。在公司募投项目实施的过程中，可能面临行业竞争加剧、市场环境变化、生产研发过程中关键技术未能突破、市场推广不利等诸多不确定因素，可能对公司募投项目的实施进度、实施效果产生不利影响，存在募投项目延期或预期效益难以实现的风险。

##### **2、并购事项相关风险**

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司股权并募集配套资金。相关事项仍在有序推进过程中，所涉及资产的审计、评估工作尚未完成，存在多项风险。包括但不限于审批风险，本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险，可能摊薄上市公司即期回报的风险，商誉减值的风险等。

#### 四、重大违规事项

本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年1-6月，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减
营业收入	13,267.53	10,914.46	21.56%
利润总额	2,814.42	1,560.07	80.40%
归属于上市公司股东的净利润	2,770.16	1,683.14	64.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	2,525.65	1,224.91	106.19%
经营活动产生的现金流量净额	1,944.49	600.61	223.75%
主要会计数据	2025年6月30日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减
归属于上市公司股东的净资产	94,864.25	92,487.66	2.57%
总资产	103,459.88	98,215.23	5.34%

2025年1-6月，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.17	58.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.12	108.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.95	1.75	增加1.20个百分点

主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.69	1.27	增加 1.42 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	21.05	25.26	减少 4.21 个百分点

2025年1-6月，公司上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 80.40%、64.58%、106.19%，主要原因源于两方面：一是 2025 年上半年度公司持续深耕市场开拓，积极推进业务拓展，激光加工控制系统、激光精密加工设备业务均实现稳步增长；二是公司强化内部管理，费用管控得到有效控制，销售费用、管理费用、研发费用保持基本稳定，综合以上因素致各项利润增长。

2、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 58.82%、58.82%、108.33%，主要系 2025 年上半年度归属于上市公司股东的净利润增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增长了 223.75%，主要系 2025 年上半年度公司持续加强供应商管理体系，更多采用承兑汇票，致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。经过多年的积累，公司已拥有高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品，下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景。公司产品在国内的激光加工控制系统、激光精密加工设备领域，拥有先进的技术和成熟的产品线，公司在激光加工振镜控制系统领域，保持领先地位。

随着半导体、新能源、光伏等行业的发展及新技术新产品的不断推出，工业激光加工的应用越来越广泛，对应的激光加工控制技术要求也越来越高。公司针对不同行业不同应用也研发了相应的技术及产品解决方案，以保持公司在行业内

的领先地位。

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，激光制造应用优势明显。激光加工设备工作过程具有智能化、数据化、标准化、柔性化、连续性等优质特性，在增材及减材应用上都有大量涉足，并通过配套自动化设备可提高制造质量、生产效率及节约人工等，在航空航天、轨道交通、电子制造、新能源、新材料等领域的高端制造有重大发展前景。

激光工业加工当前有两个发展方向，一个是面向微米级、纳米级的加工精度发展的微纳加工，一个是面向更大幅面，加工尺寸更大的宏加工。公司的振镜控制系统产品主要应用于微纳加工，其技术发展方向为越来越高的加工精度、速度等指标。得益于当前皮秒、飞秒等超快激光器的迅速发展，微纳加工的应用领域也越来越广泛，加工效率和加工效果也逐渐可以满足市场的需求，未来的增长空间较大。同时在宏加工领域，发展方向为更高的加工效率、更大的加工尺寸等，相应的对于激光器的功率要求也越来越大。随着国内大功率激光器的技术和产品的不断发展成熟，以及国内巨大的加工市场需求，未来也有广阔的发展空间。公司的振镜控制系统产品和伺服控制系统产品分别应用于微纳加工以及宏加工领域，未来继续向高功率、高速度、高精度、多功能等方向发展，广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品等领域，市场规模将进一步扩大。

综上所述，2025年1-6月公司核心竞争力未发生不利变化。

## **七、研发支出变化及研发进展**

### **（一）研发支出及变化情况**

2025年1-6月，公司研发费用为2,793.38万元，同比增长1.30%，增速放缓，主要系公司持续强化内部管理，研发费用得到有效控制所致。

### **（二）研发进展**

2025年1-6月，公司持续对各产品进行技术研发和攻关，形成了多项新的技术及功能，同时对已有的技术也持续进行更新迭代。2025年1-6月，公司新增授权发明专利9项，实用新型专利7项，外观设计专利3项，软件著作权6项，商

标 2 项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 97 项专利（其中发明专利 51 项，实用新型专利 42 项，外观设计专利 4 项），软件著作权 148 项，商标 97 项。

2025 年 1-6 月，公司在研项目进展情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	激光调阻系统	210.00	16.51	972.02	实现高阻 1K 欧—1G 欧范围全自动测量。	高阻 1K 欧—1G 欧全量程自动测量精度优于 1%。	技术国内领先、工艺考究、整套系统稳定可靠。	高阻精密调阻
2	柔性制造平台	640.00	562.86	2,970.81	<p>1、焊接产品聚焦于锂电及汽车行业，在锂电领域，已实现方壳电池、圆柱电池各生产环节的批量应用。</p> <p>2、在汽车行业，在电驱系统、零部件焊接领域获得广泛认可。</p> <p>3、三维五轴方向已实现某公司异形曲面零件的精密切割功能，加工精度能满足业务要求。后续，进一步研究工艺参数，提升加工节拍。本项目所开发的三维五轴精密微加工解决方案，已应用于另一个应用场景，并形成销售合同。</p>	<p>焊接方向：在锂电汽车领域持续深耕，融合机器视觉与机器人技术，打造飞行焊接产品，提升汽车四门两盖焊接及锂电池汇流排焊接生产效率。</p> <p>三维五轴方向：提供面向异形曲面类零件精密切割及纹理填充加工需求，提供可靠的整体解决方案（CAM 软件，控制系统、振镜系统）。</p>	国内领先，涉及多轴运动轨迹规划、机器人运动学、计算机图形学、激光焊接工艺等技术。	<p>动力电池、汽车白车身等领域有较多应用场景</p> <p>在高端消费电子领域（VR、手表、手机、无人机等产品的曲面零部件加工），有较好的应用前景</p>
3	高精度数字振镜	699.00	419.06	2,312.02	<p>1、FS20 振镜进行一个版本的技术迭代，进入小批量试产阶段。</p> <p>2、FS30 高功率焊接振镜和 FS14-STD/HS 高精度和通用振镜基于 2025 年市场调研转回研发阶段，相关技术在 FS20 振镜验证后导入。</p> <p>3、五轴振镜方面： （1）开发装配流程及配套</p>	<p>1、针对至少 3 个重点行业的应用需求，进行性能指标优化的市场调研和分析。</p> <p>2、建立性能指标优化的效果评估体系，确保优化后的振镜在实际应用中的性能提升得到有效验证。</p> <p>3、实现振镜调校模式的智能切换和自适应</p>	<p>1、国内领先水平，涉及高精度光栅码盘设计和信号处理、振镜电机高速谐振抑制、振镜低温漂设计和算法补偿、振镜状态实时反馈监测等技术。</p> <p>2、五轴振镜方面：技术国内领先、整套系统稳定可靠。</p>	<p>FS20：3D 打印、3C；</p> <p>FS30：高功率焊接市场；</p> <p>FS14：光伏、新能源、3C、半</p>

					<p>工装。</p> <p>(2) 校正理论已完成并应用于校正流程。</p> <p>(3) 开发校正流程, 应用于上位机校正模块。</p> <p>(4) 开发上位机校正模块, 用于引导用户进行校正。</p> <p>(5) 开发上位机实现五轴振镜圆孔、矩形孔加工功能。</p>	<p>调参。</p> <p>4、五轴振镜方面: 完成最小直径 100um, 深径比 10: 1 且锥度 &lt;0.1° 的垂壁孔工艺开发。</p>		<p>导体等领域;</p> <p>五轴振镜: 航空领域无锥度圆柱孔</p>
4	激光伺服控制系统	300.00	208.60	1,245.04	<p>1、开发双头裁床控制系统。</p> <p>2、开发激光切割高速机控制系统。</p> <p>3、完成总线随控一体激光切割系统的开发。</p>	<p>1、完成裁床双头加工控制系统的 V1.0 版本现场验证及交付。</p> <p>2、完成高速机控制系统的现场验证及交付, 运行速度 120m/min, 运行加速度 2G。</p> <p>3、完成总线随控一体激光切割系统的现场验证。</p>	<p>国内领先水平, 涉及 CAD/CAM、高速多轴运动控制算法、高速多头控制算法, 高速随控一体算法。</p>	<p>裁床及激光切割领域</p>
5	转镜控制系统	420.00	25.98	850.33	<p>1、完成棱镜电机马达的设计。</p> <p>2、完成棱镜模块国产加工工艺验证。</p> <p>3、完成转镜电机驱动器研发工作。</p>	<p>实现棱镜扫描模块国产化。</p>	<p>技术领先, 激光线扫描速度达 300m/s, 并且具有稳定可靠的系统集成方案, 可满足高速激光加工应用。</p>	<p>超高速激光加工</p>
6	飞动控制系统	250.00	49.86	732.58	<p>1、完成第二版本 UI 界面修改。</p> <p>2、增加贝塞尔数据的接收和生产。</p> <p>3、修改飞行过程跳转路径, 提升加工效果。</p>	<p>产品批量稳定交付。</p>	<p>技术领先, 打码速度相比传统工艺提升 2-3 倍。</p>	<p>高速线缆、自动化、流水线产线等领域</p>
7	无限视野联动-智能控制系统	675.00	87.67	1,521.26	<p>1、完成反向间隙重要功能升级。</p> <p>2、简化参数设定, 增加加工参数的通用性。</p> <p>3、优化升级闭环控制, 联动加工同步性得到改善。</p> <p>4、完成重点客户的试用验证。</p>	<p>输出行业专用软件, 逐步提高占有率。</p>	<p>行业领先, 涉及高精度振镜、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。</p>	<p>应用于玻璃打砂、除膜领域</p>
8	激光 3D 打	200.00	58.31	897.14	<p>1、加工软件增加新功能, 跳层扫描、智能合并填充,</p>	<p>完成重点客户实现设备交付。</p>	<p>行业领先, 涉及高精度振镜控制、伺服平台控制、</p>	<p>激光 3D 打印</p>

	印系统				<p>软件底层算法优化。增加优化多零件多工艺包功能。</p> <p>2、增加表皮轮廓单独识别算法。小轮廓单独识别算法。</p> <p>3、优化多振镜拼接零件面积分配问题。</p> <p>4、解析 job 文件，加载并执行文件内容。</p> <p>5、优化多振镜逆风扫描算法。</p>		嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光 3D 打印加工工艺等多个领域。	SLA 、 SLM 、 SLS 领域
9	切打一体项目	296.49	73.37	73.37	<p>1、完成切打一体控制板卡的硬件设计。</p> <p>2、进入软硬件程序开发和调试阶段。</p>	完成切打一体产品的样机开发。	行业领先，涉及高精度振镜、伺服平台控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	覆盖膜切割、服装、鞋类
10	M30 一体机项目	154.64	17.27	17.27	<p>1、完成 M30 一体机方案验证阶段。</p> <p>2、进入到产品样机的软硬件开发阶段。</p>	完成 M30 一体机样机开发。	行业领先，涉及高精度振镜运动控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	广泛应用于中高端激光加工领域，如新能源、光伏等
11	电压调阻测量箱	49.40	3.47	3.47	<p>1、完成电压调阻测量箱的样机调试和测试。</p> <p>2、进入客户联合调试和测试阶段。</p>	完成电压调阻测量箱的样机开发。	技术国内领先、工艺考究、整套系统稳定可靠。	高精密和高速电压调阻
12	消费级产品	499.59	109.51	109.51	<p>1、完成消费级控制卡产品样机的硬件调试和测试。</p> <p>2、进入客户联合调试和测试验证阶段。</p>	完成消费级控制卡产品的样机开发。	行业领先，涉及高精度振镜运动控制、嵌入式软、硬件技术、计算机图形学、激光加工工艺等多个领域。	C 端个体、家庭用户激光打标和切割
合计		4,394.12	1,632.47	11,704.82	-	-	-	-

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金

橙子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1971号文），公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税）	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	6,793,292.25
加：募集资金理财收益	15,274,447.73
减：永久补充流动资金	126,000,000.00
减：股份回购	20,000,000.00
减：报告期内除转出前期置换资金外募投项目投入	187,535,622.08
减：募集资金现金管理投资	170,000,000.00
减：节余资金转出管理	1,416.27
截至2025年6月30日募集资金专户余额	103,275,112.11

截至2025年6月30日，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员情况如下：

项目	人员
控股股东、实际控制人	吕文杰、马会文、邱勇、程鹏
董事会成员	吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、崔银巧、田新荣、王一楠、张庆茂、李晓静
高级管理人员	吕文杰、崔银巧、陈坤、江帆、靳世伟

截至 2025 年 6 月 30 日，金橙子控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	年度内股份增减变动量	股份变动原因	截至 2025 年 6 月 30 日的质押、冻结情况
1	吕文杰	董事长、董事、总经理	1,052.60	998.18	2,050.77	-	-	无
2	马会文	董事	1,999.62	153.58	2,153.20	-	-	无
3	邱勇	董事	1,052.60	25.42	1,078.02	-	-	无
4	程鹏	董事	1,052.60	25.42	1,078.02	-	-	无
5	崔银巧	董事、财务总监	-	50.00	50.00	-	-	无
6	田新荣	董事	-	33.00	33.00	-	-	无
7	王一楠	独立董事	-	-	-	-	-	-
8	张庆茂	独立董事	-	-	-	-	-	-
9	李晓静	独立董事	-	-	-	-	-	-
10	陈坤	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-	-
11	江帆	副总经理	-	40.00	40.00	-	-	无
12	靳世伟	副总经理	-	23.00	23.00	-	-	无

金橙子控股股东、实际控制人为马会文、吕文杰、邱勇、程鹏。本持续督导期间，金橙子控股股东、实际控制人未发生变化。截至 2025 年 6 月 30 日，金橙

子控股股东、实际控制人和其他董事、高级管理人员持有的金橙子股份均不存在质押、冻结的情形。

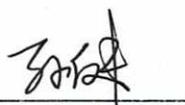
## **十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

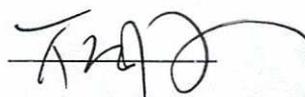
（以下无正文）

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司  
2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：



孙 健



万能鑫



国投证券股份有限公司

2025 年 9 月 11 日